

Surface
SMT
Mount

Flachprofil-Buchsenleisten

Serie CLP

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?CLP

Kontaktträger:

Liquid Crystal Polymer, schwarz
 FILE NO. E111594

Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom: 1,75 A bei 80°C

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur:

-55°C bis 125°C

Oberfläche: Sn oder Au über 50µ" (1,27 µm) Ni

Übergangswiderstand:

10 mΩ max.

Einstecktiefe:

von oben = (1,40 mm) .055"

min., von unten = (2,41 mm)

.095" zuzüglich Platinenstärke, horizontale Steckung =

(2,31 mm) .091" bis

(2,67 mm) .105"

Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

3.8oz (1,05 N) durchschn.

Haltekraft:

60 grams (0,59 N) durchschn.

Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)

2oz (0,56 N) durchschn.

Steckzyklen (max):

100 bei 10µ" (0,25 µm) Au

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C mit

Matt Zinn oder Gold

Bleifrei Lötbar:

Ja, mit Gold oder Matt Zinn

SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max. (02-35)

(0,15 mm) .006" max. (36-50)

Empfohlenes

Platinen-Layout:

Gilt nur als Vorschlag. Für

weitere Vorschläge zu Plati-

nens-Layouts fragen Sie uns

oder besuchen Sie uns unter

www.samtec.com?CLP

Diagramm:

Diagramm zeigt die Abmessungen und Positionen der Kontakte für die Optionen -PA, -DH, -P und -PA.

Abmessungen (in mm):

Reihenabstand: 100, Spaltenabstand: 99

Reihenabstand: 100, Spaltenab